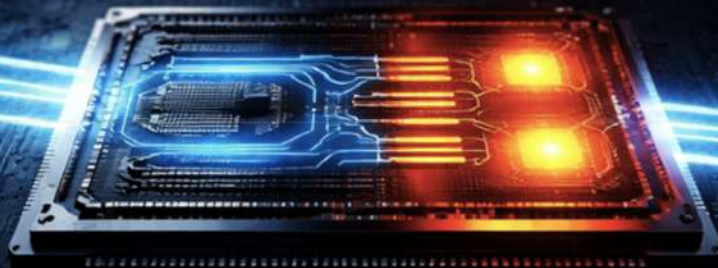


5/20

矽光子及先進封裝與熱流分析研討會



線上報名

AI算力驅動半導體產業邁向由「電」轉「光」的關鍵技術轉捩點。在高頻寬、低延遲需求持續攀升下，傳統電訊傳輸已逐漸觸及物理極限；「矽光子技術」憑藉低耗能與高整合度優勢，成為推動產業升級的核心動能。

筑波科技再次聚焦客戶最關注的新興議題——在追求高效能的同時，如何兼顧熱管理。本活動聚焦高速通訊、先進封裝（如CPO）與熱顯像分析三大關鍵領域，深入探討於高密度封裝結構中，如何透過精準檢測技術突破散熱瓶頸，並藉由前瞻測試方案優化良率，確保系統穩定運行。

同時，筑波科技亦邀請產業專家與貴賓進行專題講演，分享最新技術趨勢與實務觀點，協助產業加速技術落地。誠摯邀請產學研各界先進共襄盛舉，共同掌握光電融合技術脈動。

時間	題目	講師
13:00 – 13:30	報到與交流 Registration & Networking	
13:30 – 13:40	歡迎致詞 Opening Remarks	Mark Tsai Marketing Director, ACE
13:40 – 14:10	The Evolution of Silicon Photonics and CPO in AI Data Centers	洪瑜亨博士 Dr. Yu-Heng Hong 鴻海研究院半導體研究所 組長
14:10 – 14:30	From SiPh KGD to 1.6T Modules: ACE Comprehensive Optical Testing Ecosystem 從矽光KGD到1.6T模組：筑波科技全方位光通訊量產測試生態系	James Chang CTO / 技術長, ACE
14:30 – 14:50	AI算力時代下的重要推手—製造、測試自動化	Dr. Newton Lee Automation Sales Director, ACE
14:50 – 15:30	茶歇與展示參觀交流 Coffee Break & Demo Showcase	
15:30 – 16:00	Exploring Thermal Properties and Buried Defects with FDTR and TDTR	Dr. James Pomeroy Co-founder, Technology Advisor TherMap Solutions
16:00 – 16:20	Integrated Testing Strategies for Next-Gen Communication Systems 次世代通訊整合測試策略	Eden Chao Technical Manager, ACE
16:20 – 16:30	Q&A	